

2026年6月22日 全8頁

# AI・データセンターブームの恩恵を受けているのはどの国か？

インドネシアを除く ASEAN5 はブームの恩恵。インドはまだブームに乗り切れず

経済調査部 シニアエコノミスト 増川 智咲

## [要約]

- 2026年のアジア新興国の内需は、中東危機やスーパーエルニーニョを契機としたインフレリスクが重石となって、弱含む可能性が高まっている。その一方で、成長のドライバーとして期待されているのが輸出である。特に、AI・データセンターブームがアジア新興国の追い風となっている。
- ASEAN5（インドネシア・マレーシア・フィリピン・タイ・ベトナム）とインドの輸出構造を見ると、インドネシアとインドを除く4カ国のAI・データセンター関連輸出が増加している。半導体製造の後工程に強いマレーシアとフィリピン、電子機器の中流に強いタイ、そして最終組立など下流に強いベトナムが、日本や韓国、中国等から部品を調達するほか、香港や台湾へ再輸出を行う等して、生産工程を補い合っている。ASEAN4カ国では、東アジア地域のサプライチェーン（SC）に組み込まれていることが、AI・データセンターブームの恩恵を受ける要件となっている。
- インドは現在のところAI・データセンターブームの恩恵を享受できる生産基盤がせい弱だ。近年は、携帯電話に特化した最終組立の工程を得意としているが、それ以外の成熟工程はまだない。モディ政権下におけるインドでは、ASEANのように東アジア地域のサプライチェーンに組み込まれることで、自国で足りない工程を補完するのではなく、国内でサプライチェーンを完結させる方向で国家政策が進んでいる。そのため、半導体・電子機器産業が同国の主力輸出セクターとして成長し、AI・データセンターブームの恩恵を十分に享受するまでには時間を要するだろう。

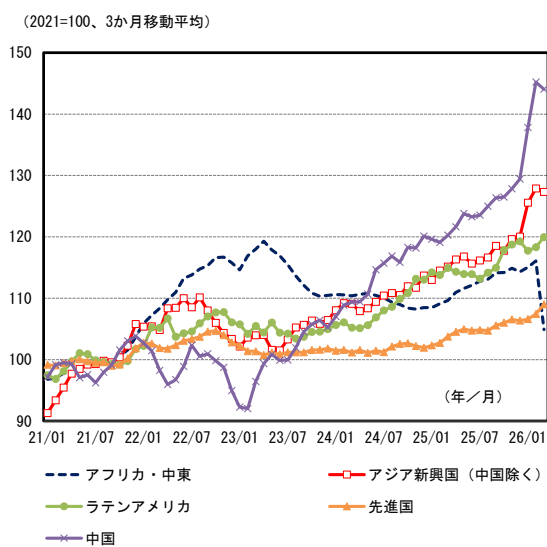
## 輸出が成長のドライバーに。ただし、アジア新興国でも明暗が分かれる

2026年のアジア新興国の内需は、中東危機やスーパーエルニーニョ<sup>1</sup>を契機としたインフレリスクが重石となって、弱含む可能性が高まっている。その一方で、成長のドライバーとして期待されているのが輸出だ。オランダ経済分析局が発表している貿易指数を見ると、中国とそれ以外のアジア新興国の輸出数量指数は、2023年を底に上昇基調を辿っている。特に、2026年に入ってからの上昇は、他地域と比べても顕著だ（図表1）。

好調な輸出の背景の一つとして考えられるのは、AI・データセンターブームに関連した半導体や電子機器輸出の増加である。世界でも有数の電子サプライチェーン（SC）を誇るアジア地域ではここ数年、半導体製造の後工程に関連した製品や電子機器の輸出が、景気の波とは関係なく堅調に推移してきた。

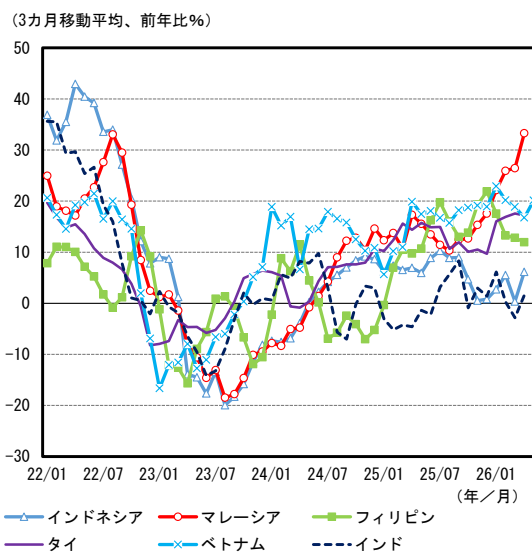
ただし、注意が必要であるのは、アジア新興国の中でもその恩恵を享受している国と、そうでない国とで明暗が分かれている点だ。ASEAN5（インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム）とインドの輸出動向を見ると、前年比で二桁増の好調を維持しているマレーシア、ベトナム、タイ、フィリピンに対し、インドネシアとインドの輸出は、2025年後半以降、低空飛行を続けている（図表2）。

図表1 輸出数量指数



(出所) オランダ経済分析局より大和総研作成

図表2 ASEAN5 とインドの輸出動向



(出所) 各国統計より大和総研作成

<sup>1</sup> 「エルニーニョ現象」とは太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象。2026年はその影響が強い「スーパーエルニーニョ」に発展する可能性が指摘されている。この場合、高温少雨によって農作物の生産高に影響が出る可能性が高い。

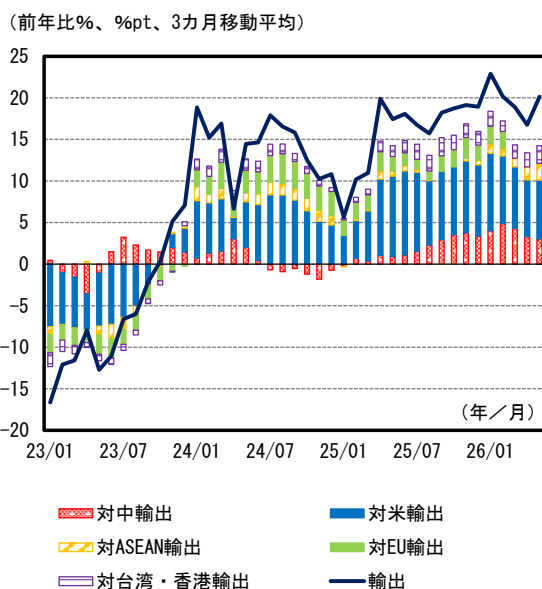
## 輸出の明暗を生んでいる要因は？

米国向け輸出がけん引役のベトナムとタイ。ただし、得意とする生産工程は異なる

図表 3～6、8～15 は、各国の輸出を国・地域別および品目別に寄与度分解したものである。まず、今回取り上げた国の中で、米国が好調な輸出のけん引役となっているのがベトナムとタイである。ベトナムからの主な対米輸出品は、「携帯電話・部品（HS コード 8517、以下数字は HS コード）」と、「自動データ処理機械・部品（8471、8473）」である。「自動データ処理機械・部品」の大半は、「マザーボード（電子部品実装済みの主要基盤）やメモリーモジュール（DRAM チップを実装したメモリ基盤）、プリント回路組立品（847330）」といったプリント基板（PCB）実装後の部品と、「ノートパソコン（847130）」である。半導体から電子機器製造までの工程でいうと、前者が「④PCB 実装」、後者が「⑥最終製品組立」にあたる（図表 7）。ベトナムでは、EMS（電子機器受託製造サービス）が主体となって輸入した中間財を使用して最終製品の組み立てを行っている。

タイからの主な対米輸出品は、ベトナムと同様に「携帯電話・部品（8517）」と、「自動データ処理機械・部品（8471、8473）」である。ただし、タイの「自動データ処理機械・部品」の内容はベトナムと異なり、AI 処理を行うサーバー（847150）や、ストレージ（847170）といった AI インフラの中核で、付加価値が比較的高い。工程では、「⑤モジュール化～⑥最終製品組立」にあたる。

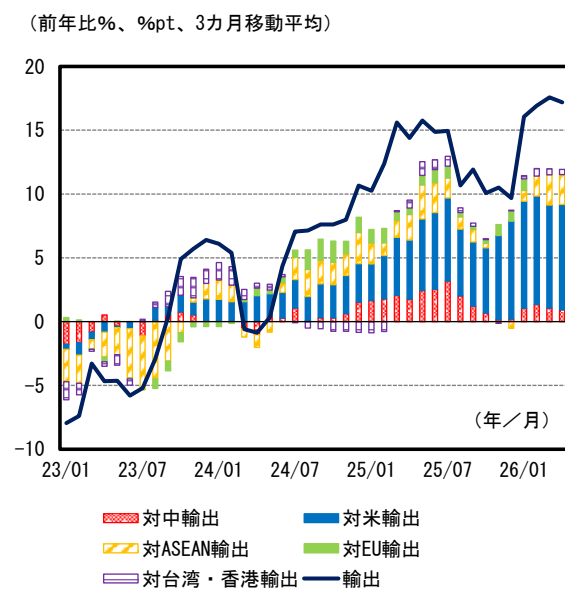
図表 3 ベトナムの輸出（国・地域別）



（注）対 EU は 2026 年 2 月まで、それ以外は同年 5 月まで。

（出所）各国統計、IMF より大和総研作成

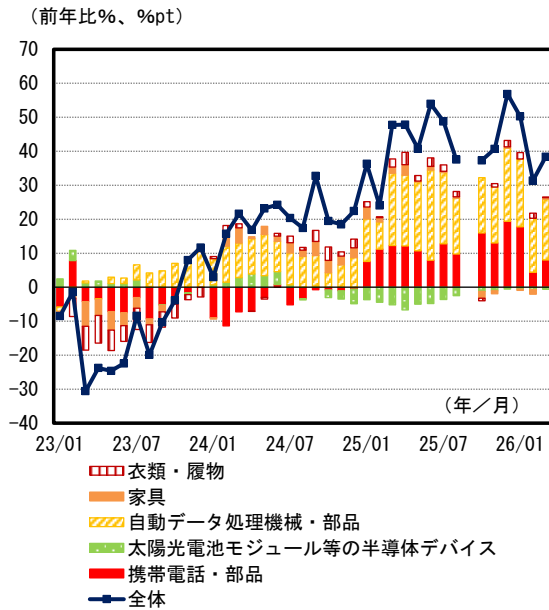
図表 4 タイの輸出（国・地域別）



（注）対 EU は 2026 年 2 月まで、それ以外は同年 4 月まで。

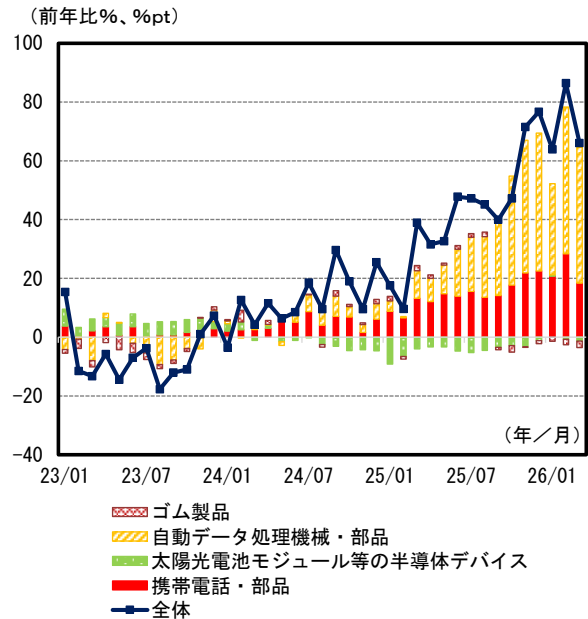
（出所）各国統計、IMF より大和総研作成

図表 5 ベトナムの対米輸出（品目別）



(注) データ制約上、米国の対越輸入額を使用。  
 (出所) UN Comtrade より大和総研作成

図表 6 タイの対米輸出（品目別）



(注) データ制約上、米国の対タイ輸入額を使用。  
 (出所) UN Comtrade より大和総研作成

図表 7 半導体製造から電子機器製造までの工程と、各国の強み

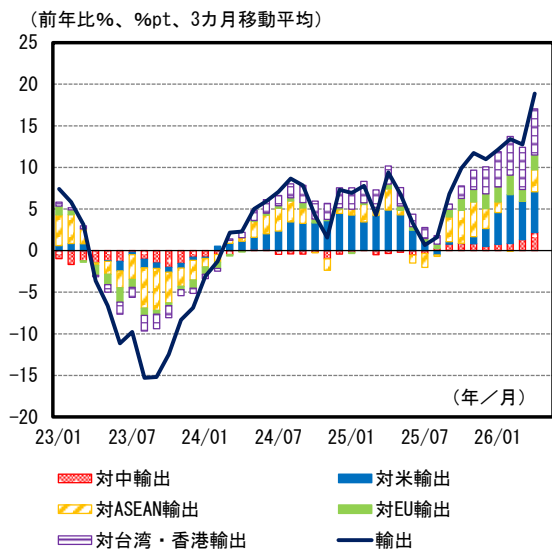
工程	① 半導体製造		② 電子部品製造	③ PCB基盤製造	④ PCB実装	⑤ モジュール化	⑥ 最終製品組立
	回路・パターン設計	前工程					
工程の内容	ソフトウェアを用いて、ICチップのデザインを行う	設計した電子回路を半導体ウェーハ表面に形成	チップに切り出して組立を行う	コンデンサやトランジスタ等の製造	部品をつなぐためのプラットフォーム製造	③に①と②を実装	基盤単位で機能化 最終製品
						ベトナム	
			マレーシア			タイ	
			フィリピン				
インド	強化中		弱	弱	強化中	弱	強

(注) マレーシアの「前工程」（ハイライトが薄い部分）は、現在強化中の箇所。  
 (出所) 各種資料より大和総研作成

後工程後に、台湾や香港への再輸出行うマレーシアとフィリピン

次に、米国だけでなく台湾や香港への輸出が大きく増加しているのが、マレーシアとフィリピンである。マレーシアからの主な輸出品は「集積回路（8542）」で、その大半がロジック IC と呼ばれる「CPU/GPU 等のプロセッサ（854231）」である。製造工程では、「①半導体製造の後工程」を終えた段階にあたる。マレーシアでは、Intel Malaysia や Infineon Technologies Malaysia (Infineon) などの IDM（設計・製造・後工程までを自社で統合して持つ半導体企業）が主体となって、AI やデータセンターに必要なとされる半導体部品を生産している。マレーシアから台湾や香港へ送られたこれらの部品は、OSAT（後工程に特化した企業）によって高度パッケージングや最終統合の処置が施される。また、米国向けには、半導体後工程で完成した IC を使い「携帯電話用のデータ通信装置（851762）」へと製品化したものも輸出している。このように、マレーシアは、半導体・電子機器サプライチェーンの中でも、比較的高付加価値な中間財の生産拠点として機能していることが分かる。

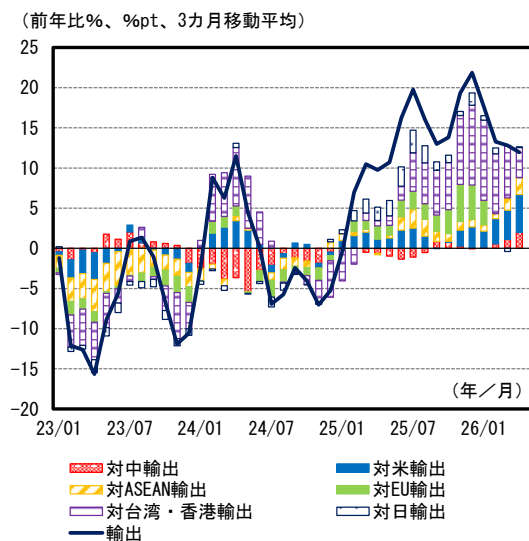
図表 8 マレーシアの輸出（国・地域別）



(注) データは 2026 年 4 月まで。

(出所) マレーシア国際貿易産業省・標準化局より大和総研作成

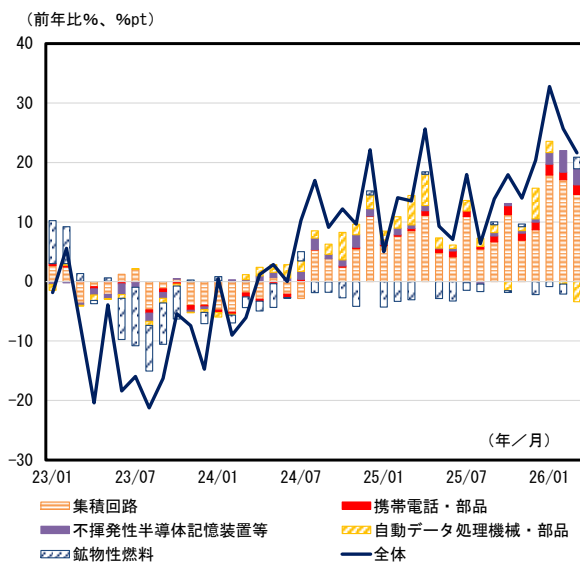
図表 9 フィリピンの輸出（国・地域別）



(注) 対 EU は 2026 年 2 月まで、それ以外は同年 4 月まで。

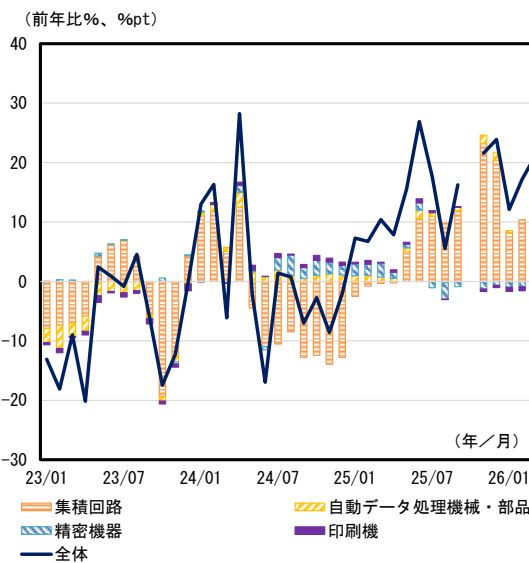
(出所) フィリピン国家統計局、IMF より大和総研作成

図表 10 マレーシアの対世界輸出（品目別）



(出所) UN Comtrade より大和総研作成

図表 11 フィリピンの対世界輸出（品目別）



(注) 2025 年 10 月のデータは未発表。

(出所) UN Comtrade より大和総研作成

フィリピンから台湾や香港へ向けた主な輸出品も、「CPU 等を含むプロセッサ及びコントローラ (854231)」や「DRAM 等のメモリ IC (854232)」で、「①半導体製造の後工程」を終えた製品である。ただし、フィリピンは、IDM の後工程施設や OSAT の数でマレーシアを大きく下回っており、「集積回路 (8542)」の輸出規模もマレーシアの 1/6 程度だ。また、マレーシアでは Infineon が前工程工場を立ち上げるなど半導体セクターの高度化が進んでいるのに対し、フィリピンでは前工程への投資は無い。半導体の先端パッケージへの参入を図るマレーシアに対し、

フィリピンは量産型製造拠点としての機能を果たしている<sup>2</sup>。

## AI ブームの恩恵を享受しにくいインドネシアとインド

上記4カ国と比べて、輸出の伸びが低調であるのがインドネシアとインドだ。インドネシアでは2025年半ば以降、中国向け輸出が堅調を維持する一方で、米国やASEAN向けの輸出寄与度が大きく縮小している（図表12）。米国向け輸出が減速した理由には、主要輸出品である衣類・履物に相互関税が課された影響が大きい。相互関税が無効化された後も、これらの輸出の回復は遅れている。またそれ以外にも、2026年2、4月に米国で、インドネシアから輸出される「太陽光電池モジュール（8541）」に相殺関税・反ダンピング関税の仮決定がなされ徴収が始まった<sup>3</sup>点も逆風となっている。

ASEAN向けでは、「石炭等の鉱物燃料（27）」の輸出が減速した。鉄鋼やニッケルなどの精錬分野の拡大で国内の石炭需要が増加し、輸出余力が縮小方向にあること<sup>4</sup>や、カーボンニュートラルへ向けた動きが進む中、ASEAN各国の石炭需要が縮小傾向にある点が挙げられる。

このように、インドネシアの輸出に影響を与えやすいのは、インドネシア産衣類や履物の消費主体である米国の低所得者層の消費動向や米国の関税政策、そして資源需要である。他方で、AI・データセンターブームに関連した輸出規模は小さく、インドネシアの輸出全体に占める「自動データ処理機械・部品（8471、8473）」や「集積回路（8542）」の割合は1%にも満たない。

インドの輸出も2025年末以降、米国向けを中心に低調に推移している。米国がインドに対して50%の関税（相互関税と制裁関税）を課したことで、ダイヤモンドなどの「貴金属（71）」輸出が減少し、高関税の撤廃後も回復に至っていないことが原因の一つだ。また、高関税を課される前に駆け込み輸出が顕著だった、「医薬品（30）」や「携帯電話・部品（8517）」に関しては、2026年前半に反動減が生じたとみられる。

また、インドから世界に向けた輸出では、2023年頃から石油の減少が目立っている。米国やEUによるロシアに対する制裁強化で、ロシア産原油を精製した石油の輸出が困難となったことや、国内需要の増加で輸出向けが減少したことが背景にあると考えられる。

このように、インドの輸出動向はダイヤモンドや石油の影響を受けやすい。電子機器では、Appleのインド進出でスマートフォン生産・輸出が加速しているが、それに必要とされる部品の多くは中国からの輸入に依存し、インドでの工程は最終組立に留まっている。AIブームの恩恵を受けやすい「集積回路（8542）」や、「自動データ処理機械（8471）」の輸出規模は限定的

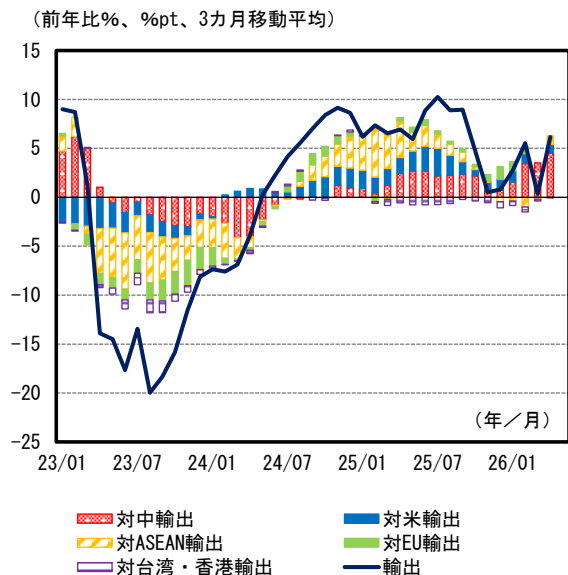
<sup>2</sup> JETRO「ASEAN主要国の産業政策と企業によるサプライチェーン対応 エレクトロニクス、量産型の輸出拠点で差別化（フィリピン2）」（2025年10月31日）

<sup>3</sup> インドネシアと同時に、インドとラオスにも同様の措置が取られている。最終決定は2026年7月の予定。

<sup>4</sup> エネルギー・金属鉱物資源機構「インドネシアの石炭政策及び石炭採掘事業者の動向と石炭需給への影響等調査」（2026年3月）

だ。インドでは近年、半導体分野の投資が相次ぎ、2026年には一部の後工程工場<sup>5</sup>が稼働を開始したが、AIブームの恩恵を受けるほどの輸出規模にはまだ至っていない。

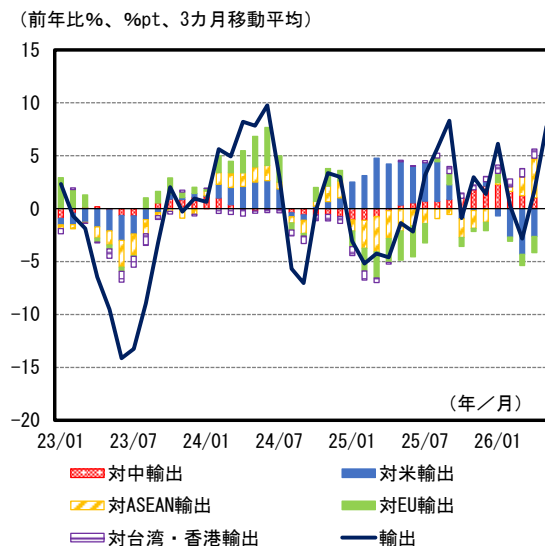
図表 12 インドネシアの輸出（国・地域別）



(注) 対EUは2026年5月まで、それ以外は同年4月まで。

(出所) インドネシア中央銀行より大和総研作成

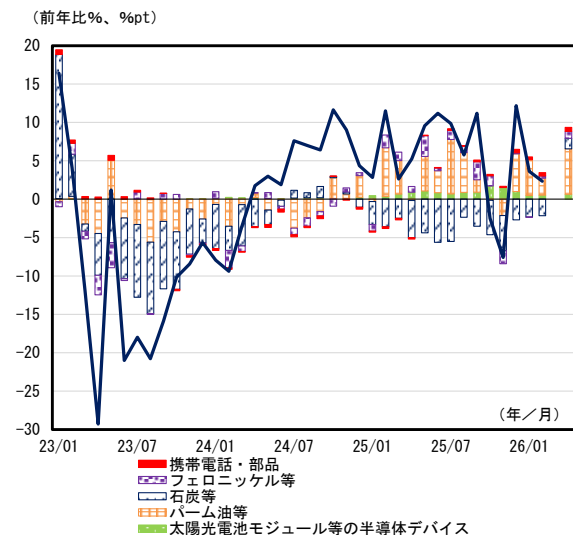
図表 13 インドの輸出（国・地域別）



(注) データは全体のみ2026年5月、内訳は同年5月まで。

(出所) インド商工省より大和総研作成

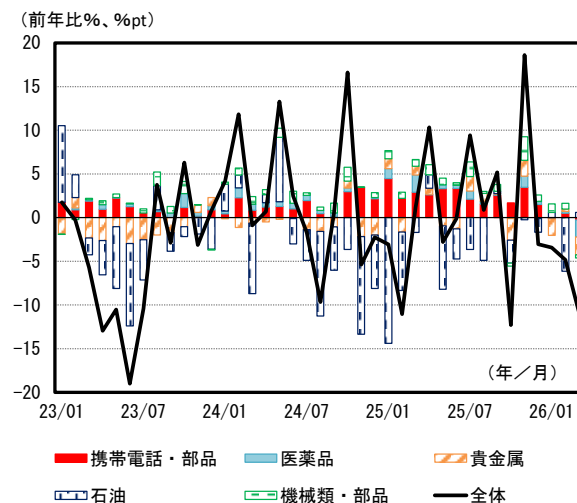
図表 13 インドネシアの輸出（品目別）



(注) データは2026年4月まで。同年3月のデータは未発表。

(出所) UN Comtrade より大和総研作成

図表 14 インドの輸出（品目別）



(注) データは2026年3月まで。

(出所) UN Comtrade より大和総研作成

<sup>5</sup> 米国マイクロン社による、グジャラート州サナンドII工業団地の半導体後工程工場と、地場ケインズ・セミコンによる同地半導体後工程工場。ケインズ・セミコンは大手EMSのケインズ・テクノロジーの半導体子会社。

## 生産工程内分業で恩恵を受ける ASEAN4 と、国内 SC の完結を模索するインド

以上のように、アジア新興国の輸出においては、インドネシアを除く ASEAN4 カ国が AI・データセンターブームの恩恵を受けていることが分かる。その構造は、半導体製造の後工程に強いマレーシアとフィリピン、電子機器の中流に強いタイ、そして最終組立など下流に強いベトナムと生産工程内の分業を基盤としている。ASEAN 域内で足りない部分に関しては、日本や韓国、中国等から部品を調達するほか、香港や台湾へ再輸出を行う等して、生産工程を補いつている。このように、ASEAN4 カ国では、東アジア地域のサプライチェーンに組み込まれていることが、AI・データセンターブームの恩恵を受ける要件となっている。

このような強みは、今後、米国が 1974 年通商法 301 条を根拠に新たな関税政策を打ち出したとしても優位に働くだろう。2026 年 2 月、米国の最高裁判所が IEEPA に基づく関税に無効判決を下したことを受け、現在米国は、1974 年通商法 122 条に基づく一律追加関税（10%）を 150 日間の時限措置として暫定的に課している。今後、この一律追加関税が 7 月に期限を迎えるにあたり、米国は 1974 年通商法 301 条に基づく新たな追加関税を検討している。具体的には、強制労働への対応不足が疑われる国・地域に調査を行い、これに認定される場合に 10.0~12.5% の追加関税を課す案が浮上している。ASEAN5 およびインドは、この調査対象国とされている。今後、通商法 301 条に基づく 10.0~12.5% の追加関税が課されたとしても、現在の一律追加関税率（10%）と大きく変わらない上、本稿で見た通り、アジアの生産工程分業体制を再現できる地域は他にないことから、ASEAN 地域の AI・データセンターブームの追い風が大きく減速することはないだろう。

他方、インドは現在のところ AI・データセンターブームの恩恵を享受できる生産基盤が弱い。 「携帯電話・部品（8517）」に特化した「⑥最終製品組立」の分野を得意としているが、それ以外の工程に関しては、モディ政権が多額の予算を投入しているものの、まだ成熟過程にはない（前掲図表 7）。モディ政権下におけるインドでは、ASEAN のように東アジア地域のサプライチェーンに組み込まれることで、自国で足りない工程を補完するのではなく、国内でサプライチェーンを完結させる方向で国家政策が進んでいる。そのため、半導体・電子機器産業が同国の主力輸出セクターとして成長し、AI・データセンターブームの恩恵を十分に享受するまでには時間を要するだろう。